

## 臺灣半導體產學研發聯盟

### 110年配合科技部計畫推薦作業流程與注意事項

#### 一、簡介

臺灣半導體產學研發聯盟(TIARA, Taiwan IC Industry and Academia Research Alliance)為產、學、研團體會員共同組成之非營利社團法人，其任務為促進我國半導體領域之產學研發合作，及培育並鼓勵人才投入博士級高階研發工作。

TIARA 推動 A + A' 產學桂冠計畫架構，其【A計畫】為企業會員出資與學研界合作共同開發業界需求之競爭前(pre-competitive)產業技術，【A'計畫】則由政府加碼補助，針對已形成或即將形成【A計畫】之學研界團隊，進行與【A計畫】主題相關的前瞻學術研究。

110年度科技部前瞻技術產學合作計畫之產學研發聯盟型計畫(即原REAL計畫、【A'計畫】)已於110年05月06日正式公告徵求。TIARA 為計畫推薦機構之一，作業流程與注意事項，請參考本說明文件。

#### 二、申請推薦之資格(非TIARA會員亦可提出申請)

經企業與合作學術研究單位(以下簡稱學界)議定研發主題並簽署合作意向書(詳如附件一)或已有產學合作合約書者，即可由符合科技部補助資格之學研界計畫主持人向 TIARA 提出推薦申請，經審查通過後，取得申請科技部補助所需之檢附之推薦證明文件。

#### 三、TIARA推薦計畫研發範疇

晶片設計、製造、封裝及測試等產業及其應用、軟體、平台、系統與材料、設備、設計自動化等領域所需之競爭前先導前瞻產業技術，以增加產業未來競爭力為目標，屬於高風險、高創新或需長期研發之先期研究計畫。

#### 四、TIARA推薦之計畫標的與規範

分【A計畫】及【A'計畫】分別說明如下：

【A計畫】內容須符合《臺灣半導體產學冠桂計畫作業要點》及《臺灣半導體產學冠桂計畫作業辦法》之規範，敬詳 TIARA 官網[【請按我請往】](#)。重點摘述如下：

1. 【A計畫】可為一對一、一對多或整合型計畫，期程以多年期為原則，業

界出資每年經費原則為新臺幣一佰萬元以上；**唯自110年起，配合科技部補助計畫條件，上修業界出資金額為新臺幣二百萬元以上，請申請人依110年條件辦理。**

2. **【A計畫】**應有博士生或博士後研究人員參與，並支領研究津貼，每人每月原則為新臺幣二萬元以上（計畫是否有博士生參與為政府補助**【A'計畫】**審查評分項目之一，將優先補助有博士生/博士級人員參與之計畫）。
3. **【A計畫】**研究主題、方向及內容為機密資訊，TIARA 執行推薦作業期間負妥善保密之責，參與推薦作業人員均應簽署保密切結書，並落實利益迴避原則。
4. **【A計畫】**執行期間如進度或成果不符預期，得經產學團隊合作雙方自行協議啟動計畫退場機制或終止執行，唯**【A'計畫】**補助經費之處置依補助機關規定辦理。
5. **【A計畫】**研發成果以雙方均等共有為原則，且參與之各方均可基於該研發成果，各自獨立延伸發展相關技術及專利，另出資企業享有購買該研發成果完整權利之優先權。**【A'計畫】**計畫之研發成果依補助機關規定，出資企業於計畫結束一年內有先協商授權或讓與之權利。

**【A'計畫】**內容悉依補助機關之公告辦理。110年度科技部前瞻技術產學合作計畫公告網址：**[【請按我請往】](#)**

## 五、TIARA推薦作業時程（共五階段）

1. **【申請推薦】**配合科技部110年作業時程，TIARA 自即日起受理申請，申請機構學研界計畫主持人須填詳實填寫**【A+A'計畫】**構想書（**詳如附件**），於**110年07月16日**前加密檔案以電子郵件寄送至 TIARA 收件信箱：[tiaratwic@gmail.com](mailto:tiaratwic@gmail.com)，並請來電確認收件情形（03-5912777）。
2. **【初審】**TIARA 收件後進行文件初審，文件不符或有缺漏將通知補件，申請機構計畫主持人應於通知後**三個工作日**內完成補件，逾期不予受理並註銷申請。
3. **【書審】**TIARA 進行書面審查，經審查後如需補充有關資料或進行其他說明，將回復審查意見並通知補件，申請機構應於通知後**七個工作日**內完成補件，未補件或補件後複審未通過者不予推薦。
4. **【核證】**經書審通過者，TIARA將立即通知申請人，並於**110年08月03日**前寄發認可推薦證明（**詳如附件二**）。
5. **【申請補助】**配合科技部110年作業時程，於**110年08月13日**前依

公告說明辦理，同時檢附推薦證明文件。

#### 六、TIARA建議經費編列與動支原則

1. TIARA 產學桂冠計畫架構之【A計畫】與【A'計畫】（即業界出資與政府補助）之經費比例以六比四（6:4）為原則，**建議申請政府補助之金額不高於業界出資金額**。
2. 【A計畫】經費之編列及運用，由產學團隊合作雙方自行協議，唯參與計畫之博士生研究津貼，每名每月以不低於新臺幣二萬元為原則。
3. TIARA 與會員學校均已簽署合作意向書，校方同意《臺灣半導體產學冠桂計畫經費管理辦法》之範圍，請與校方或 TIARA 洽詢。
4. 【A'計畫】申請經費之編列與動支，悉依補助機關之公告辦理。

#### 七、計畫執行與管考

1. 【A計畫】於執行期間由產學團隊合作雙方自行管考。
2. 獲【A'計畫】補助者，學研機構另應自行完成政府補助計畫相關合約之簽訂，其獲政府補助部份之管考，由補助機關之之規範辦理。
3. 【A計畫】與【A'計畫】執行期間如遇管考事項疑異，歡迎洽詢 TIARA 協助確認及協調。

※臺灣半導體產學研發聯盟辦公室

聯絡人：江政龍博士／電話：03-5912777／E-mail：[jlchiang@tiara.org.tw](mailto:jlchiang@tiara.org.tw)

※科技部專案補助計畫聯絡窗口：

科技部產學研發聯盟合作計畫辦公室

聯絡人：陳于純小姐／電話：02-27377288／E-mail：[yuchchen@narlabs.org.tw](mailto:yuchchen@narlabs.org.tw)

科技部產學及園區業務司

承辦人：林技寬先生／電話：02-27377280／E-mail：[jklin@most.gov.tw](mailto:jklin@most.gov.tw)

【A+A'計畫構想書（推薦機構審核資料）】請精要敘述，篇幅以至多10頁為原則。

### 一、計畫基本資料

填寫說明：

1. 本表填需填寫由業界出資之產學合作計畫（即【A計畫】）資訊，不含擬向科技部申請之補助部份。
2. 若無其他共同執行公司，相關欄位請留空白或刪除；若超過一家共同執行公司，請於「共同執行公司一」欄位後增列；若有多個學研機構參與，或為多個子計畫之整合型計畫，請比照列明。
3. 計畫經費配合科技部補助之規定，每年業界出資現金總合須大於或等於新臺幣二百萬元，請分年列出；若為一年期計畫，第二年欄位請留空白或刪除，若期程超過二年，請自行增列。

計畫名稱	中文			
	英文			
主題領域 (可複選)	<input type="checkbox"/> 電路設計 (circuit design, libraries, and EDA tools...) <input type="checkbox"/> 下世代通訊 (communication and networking...) <input type="checkbox"/> 人工智慧與無人載具 (artificial intelligence and unmanned vehicles...) <input type="checkbox"/> 生醫與智慧感測 (biomedical and smart sensors...) <input type="checkbox"/> 高效能運算 (high-performance hardware and system architecture...) <input type="checkbox"/> 前瞻性半導體科技 (emerging memory, devices, and advanced technology...) <input type="checkbox"/> 綠能與電力電子 (power electronics and green energy...) <input type="checkbox"/> 製程與封測 (manufacturing process, packaging and testing...)			
主導公司 (A) 名稱	(公司全名)			
主導公司 (A) 計畫主持人		職稱		
共同執行公司一 (B) 名稱	(公司全名)			
共同執行公司一 (B) 計畫主持人		職稱		
主導學研機構 / 系所 (單位)				
主導學研機構主持人		職稱		
共同學研機構一 / 系所 (單位)				
共同學研機構一主持人		職稱		
是否規劃博士班研究生 (或博士級研究人員) 共同參與計畫執行				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
計畫總經費	新臺幣 _____ 元 (S1+S2+...)			

TIARA A+A'計畫構想書

分年列出	項 目	金 額 (元)	佔年度經費百分比
第一年 __年__月__日 至 __年__月__日	主導公司投入研發經費 (A1)		%
	共同執行公司一投入研發經費 (B1)		%
			%
	第一年小計 (S1=A1+B1+...)		100%
第二年 __年__月__日 至 __年__月__日	主導公司投入研發經費 (A2)		%
	共同執行公司一投入研發經費 (B2)		%
			%
	第二年小計 (S2=A2+B2+...)		100%
主導公司 (A) 計畫連絡人	姓名：	聯絡電話：	
	E-mail：		
共同執行公司一 (B) 計畫連絡人	姓名：	聯絡電話：	
	E-mail：		
主導學研機構計畫連絡人	姓名：	聯絡電話：	
	E-mail：		
共同學研機構一計畫連絡人	姓名：	聯絡電話：	
	E-mail：		

## 貳、【A+A'計畫】內容說明

填寫說明：

1. 請簡述【A+A'計畫】研究內容及研究方法，建議分【A計畫：業界出資合作部份】與【A'計畫：申請科技部補助部份】概述之，並說明兩者之關聯性；後者之研發內容應較前者更具前瞻性。
2. 如有屬無法揭露之機密資訊，請自行斟酌陳述內容及方式，確保足以評判：
  - (1) 【A計畫】屬市場競爭前之技術
  - (2) 【A'計畫】屬更前瞻之學術研究

### (3) 【A計畫】與【A'計畫】之相關性

#### 一、研究方向與目的

【A計畫：合作企業出資部份】

【A'計畫：申請科技部補助部份】

【A計畫與A'計畫相關性說明】

#### 二、執行方法

【A計畫：合作企業出資部份】

第一年

第二年

【A'計畫：申請科技部補助部份】

第一年

第二年

#### 三、產學合作團隊分工方式

填寫說明：請概述主導公司、各共同執行公司及學研機構在計畫中之合作架構或配合方式。

#### 三、預期產出與成果效益

填寫說明：請列述預期之研發標的或技術指標，並明確區別業界出資合作部份與申請科技部補助部份之產出與成果；後者可在說明學術價值之外，強調產業技術提升或產學合作加值效應等。

【A計畫：合作企業出資部份】

【A'計畫：申請科技部補助部份】

## 參、其他內容或附件

說明：

1. 請檢附合作企業簽署之合作意向證明文件做為佐證資料，以下擇一：

(1) 科技部前瞻產學研發計畫申請書之表1-1或表1-2

(2) 填具本文件附件一「申請人與企業之合作約定書」

(3) 提供申請人與企業之合作合約部份資訊（僅需揭示封面、計畫名稱、經費及期程等部份；如有機密考量，建議採用前項「申請人與企業之合作約定書」方式辦理）

2. 若擬自行補充或檢附其他有助審查之參考資訊，敬請以至多5頁為原則。

【申請人與合作企業之合作約定書】

本公司（名稱：\_\_\_\_\_）願共同參與  
（總）計畫主持人：\_\_\_\_\_產學合作研發計畫（計畫名稱或合作方向：  
\_\_\_\_\_），並遵守下

列事項：

- 一、本公司與（總）計畫主持人等於上列產學合作研發計畫，合作期間：  
自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日止。
- 二、本公司提供研發經費全程總計新臺幣\_\_\_\_\_元。
- 三、本公司分年撥付研發經費（單位：元）：  
第一年：\_\_\_\_\_、第二年：\_\_\_\_\_、第三年：\_\_\_\_\_
- 四、本公司所撥付經費，並非來自政府補助款項。

此致

社團法人臺灣半導體產學研發聯盟

合作企業代表人：\_\_\_\_\_（簽章）

合作企業用 印：

（備註：可由合作企業授權之研發部門主管或代表簽章即可，毋須加蓋公司大、小章。）

中華民國\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附件二

【臺灣半導體產學研發聯盟推薦證明】

申請人\_\_\_\_\_吸引業界\_\_\_\_\_投入屬產業前瞻技術研究與開發（合作主題：\_\_\_\_\_）之研發經費，滿足下列條件：

1. 投入經費執行期間：

自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日止

2. 企業承諾出資研發總經費：\_\_\_\_\_仟元

第一年：\_\_\_\_\_仟元；第二年：\_\_\_\_\_仟元；第三年：\_\_\_\_\_仟元

3.

檢附【申請人與合作企業之合作約定書】

檢附【申請人與企業之合作合約】

檢附【合作企業參與合作計畫經費承諾書】以茲為證

本機構推薦此計畫申請科技部前瞻技術產學合作計畫-產學研發聯盟型。

此致

科技部

計畫推薦機構負責人：\_\_\_\_\_（簽章）

計畫推薦機構用 印：\_\_\_\_\_（機構章）

中華民國\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日